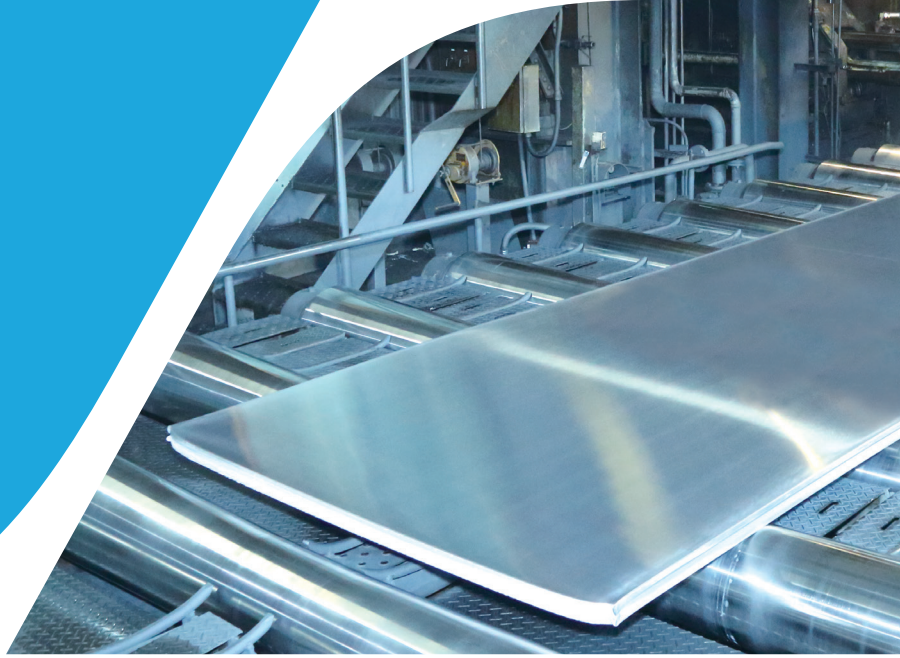


UACJ 표준 알루미늄 합금판

FusPlate

퍼스플레이트

FusPlate는 일반 후판(JIS 규격 A5052)의 품질기준을 업그레이드한 UACJ 후판 표준 제품입니다.(합금·재질 A5052-H112)



UACJ의 제조 기술력으로 판 두께 공차와 평탄도가 향상, 잔류응력의 감소로 고객의 가공 공정에서의 비용 절감이 가능해집니다.

특징

- 판 두께 공차는 JIS의 1/3~1/5을 확보
- 잔류응력 및 평탄도는 일반 후판보다 우수
- 잔류응력의 감소로 절단 및 절삭 가공 시 흠 발생 감소
- 가공 공정 및 힘 교정 공정을 생략할 수 있어 비용 절감
- 표면 보호필름 부착
- 판 두께 범위는 4 mm~100 mm



용도 예

- 반도체 제조장치
- 액정 제조장치
- 전기제품
- 의료기기
- OA기기
- 광학기기
- 각종 금형
- 가공 지그



알루미늄 후판 전문공장

주식회사 UACJ 후카야 제조소

FusPlate는 후판 전문공장인 후카야 제조소에서 제조하고 있습니다. 최신 설비와 뛰어난 제조 기술로 두께 공차와 평탄도가 뛰어난 고품질 알루미늄 후판을 제조하여 고객의 니즈를 충족시켜 드립니다.

제조 사이즈

단위 mm

판 두께	폭×길이
4~100	1,000 × 2,000
	1,250 × 2,500
	1,525 × 3,050

화학 성분

단위 Wt/%

합금	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	기타		Al
									개별	합계	
5052	0.25 이하	0.40 이하	0.10 이하	0.10 이하	2.2 ~2.8	0.15 ~0.35	0.10 이하	—	0.05 이하	0.15 이하	기타

두께 공차

단위 mm

판 두께	4	5	6	7~12	13~15	16~17	18~19	20~21
공차	±0.06	±0.07	±0.08	±0.10	±0.15	±0.16	±0.18	±0.20

판 두께	22	23~27	28~35	36~49	50~54	55~64	65~74	75~100
공차	±0.22	±0.25	±0.30	±0.40	±0.50	±0.60	±0.65	±0.85

평탄도

단위 mm

판 두께	평탄도
4~30	0.2 이하/1,000(폭·길이)
31~50	0.3 이하/1,000(폭·길이)
51~100	1.2 이하/1,000(폭·길이)

기계적 성질(대표 값)

판 두께(mm)	인장 강도(N/mm ²)	연신율(%)
4~13	216	25
14~100	209	27

UACJ Corporation

Plate사업 본부 후판·수송재 영업부

우편번호 100-0004

도쿄도 지요다구 오테마치 1초메 7번 2호 도쿄 산케이 빌딩

TEL: +81-3-6202-2663 FAX: +81-3-6202-2031

<https://www.uacj.co.jp/english/>